

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
12. Mai 2005 (12.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/043482 A2**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G08C 17/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/012351

(22) Internationales Anmeldedatum:  
28. Oktober 2004 (28.10.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 51 719.7 31. Oktober 2003 (31.10.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): IHP GMBH-INNOVATIONS FOR HIGH

PERFORMANCE MICROELECTRONICS / INSTI-  
TUT FÜR INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK  
[DE/DE]; Im Technologiepark 25, 15236 Frankfurt (Oder)  
(DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GUSTAT, Hans  
[DE/DE]; Am Ziestsee 4, 15752 Prieros (DE).

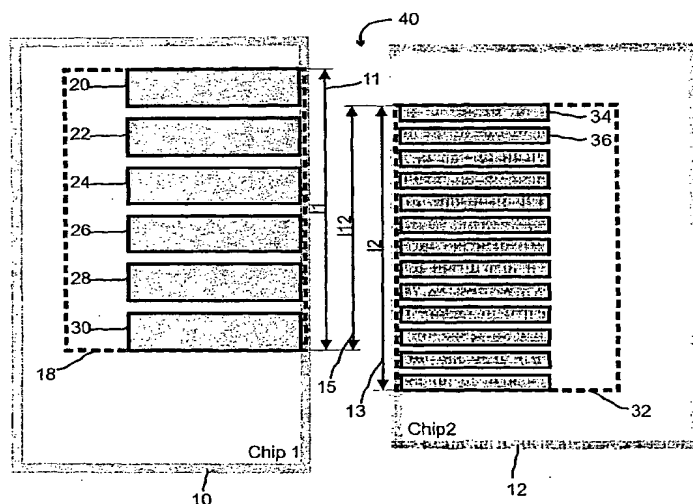
(74) Anwalt: EISENFÜHR, SPEISER & PARTNER; Anna-  
Louisa-Karsch-Str. 2, 10178 Berlin (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PROCESSOR COMPONENT

(54) Bezeichnung: PROZESSORBAUSTEIN



(57) Abstract: The invention relates to a chip arrangement comprising a first chip having at least one first signal interface with first coupling elements disposed along a first line in a first number density, and at least one second chip having at least one second signal interface with second coupling elements disposed along a second line in a second number density. The first and second coupling elements are adapted to allow contactless signal transmission between the first and second signal interface. The first and the second chip are arranged relative to each other in such a way that coupling elements of the first and the second signal interface are enabled to cooperate to transmit signals in a contactless manner. The longitudinal extension of at least one of the signal interfaces along the line associated therewith is longer than the length of the overlap of the two longitudinal extensions. One of the signal interfaces has a higher number density of coupling elements than the other one.

(57) Zusammenfassung: Chip-Anordnung mit einem ersten Chip, der mindestens eine erste Signalschnittstelle mit längs einer ersten Linie in einer ersten Anzahldichte angeordneten ersten Kopplungselementen aufweist, und mit mindestens einem zweiten Chip, der mindestens eine zweite Signalschnittstelle mit längs einer zweiten Linie in einer zweiten Anzahldichte angeordneten zweiten Kopplungselementen

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/043482 A2